

2020年中国半导体行业投资分析报告- 行业现状与发展商机研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国半导体行业投资分析报告-行业现状与发展商机研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/508946508946.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 半导体行业概述

第一节 半导体的定义和分类

一、半导体的定义

二、半导体的分类

三、半导体的应用

第二节 半导体产业链分析

一、半导体产业链结构

二、半导体产业链流程

三、半导体产业链转移

第二章 2017-2020年全球半导体产业发展分析

第一节 2017-2020年全球半导体市场总体分析

一、市场销售规模

二、产业研发投入

三、行业产品结构

四、区域市场格局

五、市场竞争状况

六、市场贸易规模

七、资本支出预测

八、产业发展前景

第二节 2017-2020年美国半导体市场发展分析

一、产业发展综述

二、市场发展规模

三、市场贸易状况

四、研发支出规模

五、行业并购动态

六、产业发展战略

七、未来发展前景

第三节 2017-2020年韩国半导体市场发展分析

一、产业发展综述

二、市场发展规模

三、市场贸易状况

四、技术发展方向

第四节 2017-2020年日本半导体市场发展分析

一、行业发展历史

二、市场发展规模

三、细分产业状况

四、市场贸易状况

五、行业发展经验

六、未来发展措施

第五节 其他国家

一、荷兰

二、英国

三、法国

四、德国

第三章 中国半导体产业发展环境分析

第一节 政策环境

一、智能制造发展战略

二、集成电路相关政策

三、中国制造支持政策

四、智能传感器行动指南

五、产业投资基金支持

第二节 经济环境

一、宏观经济发展现状

二、工业经济运行状况

三、经济转型升级态势

四、未来经济发展展望

第三节 社会环境

一、移动网络运行状况

二、可穿戴设备的普及

三、研发经费投入增长

四、科技人才队伍壮大

第四节 技术环境

一、高密度嵌入设计技术

二、跨学科横向发展运用

三、突破极限的开发发展

第四章 2017-2020年中国半导体产业发展分析

第一节 中国半导体产业发展综述

一、行业发展历程

二、行业发展意义

三、产业发展基础

第二节 2017-2020年中国半导体市场运行状况

一、产业发展态势

二、产业销售规模

三、市场规模现状

四、产业区域分布

五、市场机会分析

第三节 中国半导体产业发展问题分析

一、产业技术落后

二、产业发展困境

三、应用领域受限

四、市场垄断困境

第四节 中国半导体产业发展措施建议

一、产业发展战略

二、产业国产化发展

三、加强技术创新

四、突破垄断策略

第五章 2017-2020年中国半导体行业上游半导体材料发展综述

第一节 半导体材料相关概述

一、半导体材料基本介绍

二、半导体材料主要类别

三、半导体材料发展特征

四、半导体材料产业图谱

第二节 2017-2020年全球半导体材料发展状况

一、市场销售规模

二、区域分布状况

三、细分市场结构

四、市场竞争状况

第三节 2017-2020年中国半导体材料行业运行状况

- 一、应用环节分析
- 二、产业政策支持
- 三、市场销售规模
- 四、细分市场结构
- 五、产业转型升级

第四节 半导体制造主要材料：硅片

- 一、硅片基本简介
- 二、硅片生产工艺
- 三、市场竞争状况
- 四、市场投资状况
- 五、市场需求预测

第五节 半导体制造主要材料：靶材

- 一、靶材基本简介
- 二、靶材生产工艺
- 三、市场发展规模
- 四、全球市场格局
- 五、国内市场格局
- 六、技术发展趋势
- 七、市场规模预测

第六节 半导体制造主要材料：光刻胶

- 一、光刻胶基本简介
- 二、光刻胶工艺流程
- 三、行业运行状况
- 四、全球产业格局
- 五、国内产业格局

第七节 其他主要半导体材料市场发展分析

- 一、掩膜版
- 二、CMP抛光材料
- 三、湿电子化学品
- 四、电子气体
- 五、封装材料

第八节 中国半导体材料行业存在的问题及发展对策

- 一、行业发展滞后
- 二、产品同质化问题

三、供应链不完善

四、行业发展建议

五、行业发展思路

第九节 半导体材料产业未来发展前景展望

一、行业发展趋势

二、行业需求分析

三、行业前景分析

第六章 2017-2020年中国半导体行业上游半导体设备发展分析

第一节 半导体设备相关概述

一、半导体设备重要作用

二、半导体设备主要种类

三、半导体设备主要厂商

第二节 2017-2020年全球半导体设备市场发展形势

一、市场销售规模

二、市场结构分析

三、市场区域格局

四、重点厂商介绍

五、市场发展预测

第三节 2017-2020年中国半导体设备市场发展现状

一、市场销售规模

二、行业主要厂商

三、市场国产化趋势

第四节 半导体产业链主要环节核心设备分析

一、硅片制造设备

二、晶圆制造设备

三、封装测试设备

第五节 中国半导体设备市场投资机遇分析

一、行业投资机会分析

二、建厂加速拉动需求

三、产业政策扶持发展

第七章 2017-2020年中国半导体行业中游集成电路产业分析

第一节 2017-2020年中国集成电路产业发展综况

一、集成电路产业链

二、产业政策推动

三、产业发展特征

四、产业销售规模

五、产品产量规模

六、区域分布情况

七、市场贸易状况

第二节 2017-2020年中国IC设计行业发展分析

一、行业发展历程

二、市场发展规模

三、企业发展状况

四、产业地域分布

五、细分市场发展

第三节 2017-2020年中国IC制造行业发展分析

一、制造工艺分析

二、晶圆加工技术

三、市场发展规模

四、企业排名状况

五、行业发展措施

第四节 2017-2020年中国IC封装测试行业发展分析

一、封装基本介绍

二、封装技术趋势

三、芯片测试原理

四、芯片测试分类

五、市场发展规模

六、企业排名状况

七、技术发展趋势

第五节 中国集成电路产业发展思路解析

一、产业发展建议

二、产业突破方向

三、产业创新发展

第六节 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

一、全球市场趋势

二、行业发展机遇

三、市场发展前景

第八章 2017-2020年其他半导体细分行业发展分析

第一节 2017-2020年传感器行业分析

- 一、行业发展历程
- 二、市场发展规模
- 三、区域分布格局
- 四、市场竞争格局
- 五、主要竞争企业
- 六、企业运营状况
- 七、未来发展趋势

第二节 2017-2020年分立器件行业分析

- 一、市场发展规模
- 二、市场需求状况
- 三、市场发展格局
- 四、行业集中程度
- 五、上游市场状况
- 六、下游应用分析

第三节 2017-2020年光电器件行业分析

- 一、行业政策环境
- 二、行业产量规模
- 三、行业面临挑战
- 四、行业发展策略

第九章 2017-2020年中国半导体行业下游应用领域发展分析

第一节 半导体下游终端需求结构

第二节 消费电子

- 一、产业发展规模
- 二、产业创新成效
- 三、产业链条完备
- 四、产业发展趋势

第三节 汽车电子

- 一、产业相关概述
- 二、产业链条结构
- 三、市场发展规模
- 四、市场竞争形势
- 五、产业驱动因素

第四节 物联网

- 一、产业核心地位
- 二、产业政策支持
- 三、产业发展规模
- 四、市场竞争状况
- 五、产业发展展望

第五节 创新应用领域

- 一、5G芯片应用
- 二、人工智能芯片
- 三、区块链芯片

第十章 2017-2020年中国半导体产业区域发展分析

第一节 中国半导体产业区域布局分析

第二节 长三角地区半导体产业发展分析

- 一、区域市场发展形势
- 二、上海产业发展现状
- 三、杭州产业布局动态
- 四、江苏产业发展规模

第三节 京津冀区域半导体产业发展分析

- 一、区域产业发展总况
- 二、北京产业发展态势
- 三、天津推进产业发展
- 四、河北产业发展意见

第四节 珠三角地区半导体产业发展分析

- 一、广东产业发展概况
- 二、深圳产业发展规划
- 三、广州积极布局产业
- 四、东莞产业快速发展

第五节 中西部地区半导体产业发展分析

- 一、四川产业支持政策
- 二、湖北产业发展状况
- 三、重庆产业发展综况
- 四、陕西产业布局分析
- 五、安徽产业发展目标

第十一章 国外半导体行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 三星（Samsung）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第二节 英特尔（Intel）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第三节 SK海力士（SK hynix）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第四节 美光科技（Micron Technology）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第五节 高通公司（QUALCOMM, Inc.）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第六节 博通公司（Broadcom Limited）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析
- 四、企业竞争优势分析

第七节 德州仪器（Texas Instruments）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第八节 东芝 (Toshiba)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第九节 西部数据 (Western Digital Corp.)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十节 恩智浦 (NXP Semiconductors N.V.)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十二章 中国半导体行业企业分析 (随数据更新有调整)

第一节 中国半导体行业上市公司运行状况分析

一、中国半导体行业上市公司规模

二、中国半导体行业上市公司分布

第二节 中国半导体行业财务状况分析

一、经营状况分析

二、盈利能力分析

三、营运能力分析

四、成长能力分析

五、现金流量分析

第三节 华为海思

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第四节 展讯 (紫光展锐)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第五节 中兴微电

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第六节 士兰微

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第七节 台积电

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第八节 中芯国际

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第九节 华虹半导体

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十节 华大半导体

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

四、企业发展动态

第十一节 长电科技

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十二节 北方华创

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十三章 2017-2020年中国半导体行业产业链项目投资案例深度解析

第一节 中环股份集成电路用半导体硅片之生产线项目

一、项目投资背景

二、项目基本情况

三、项目投资价值

四、项目经济效益

第二节 中微公司高端半导体设备扩产升级项目

一、项目投资背景

二、项目基本情况

三、项目投资价值

四、项目投资估算

五、项目实施规划

六、项目经济效益

第三节 协鑫集成大尺寸再生晶圆半导体项目

一、项目投资背景

二、项目基本情况

三、项目投资价值

四、项目投资估算

五、项目经济效益

第四节 乾照光电VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目

一、项目投资背景

二、项目基本情况

三、项目投资价值

四、项目经济效益

五、项目投资风险

第十四章 半导体产业投资价值综合评估

第一节 半导体产业投资状况分析

- 一、产业并购规模
- 二、产业投资态势
- 三、产业并购案例
- 四、重点收购事件

第二节 半导体产业进入壁垒评估

- 一、竞争壁垒
- 二、技术壁垒
- 三、资金壁垒

第三节 集成电路产业投资价值评估及投资建议

- 一、投资价值综合评估
- 二、市场机会矩阵分析
- 三、产业进入时机分析
- 四、产业投资风险剖析
- 五、产业投资策略建议

第十五章 中国半导体产业未来发展前景及趋势分析

第一节 中国半导体产业未来发展前景展望

- 一、产业发展机遇
- 二、技术发展利好
- 三、自主创新发展
- 四、产业地位提升
- 五、产业应用前景

第二节 2021-2026年半导体产业预测分析

- 一、2021-2026年半导体产业销售额预测
- 二、2021-2026年中国半导体细分市场预测

图表目录

图表：半导体分类结构图

图表：半导体分类

图表：半导体分类及应用

图表：半导体产业链示意图

图表：半导体上下游产业链

图表：半导体产业转移和产业分工

图表：集成电路产业转移状况

图表：全球主要半导体厂商

图表：2017-2020年全球半导体市场营收规模及增长率

图表：2020年全球研发支出前十大排名

图表：2017-2020年全球集成电路占半导体比重变化情况

图表：2020年全球半导体细分产品规模分布

图表：2020年全球半导体市场区域分布

图表：2017-2020年全球半导体市场区域增长

图表：2020年全球营收前10大半导体厂商

图表：2020年全球主要国家和地区集成电路出口金额

图表：2020年全球主要国家和地区集成电路进口金额

图表详见报告正文 (GYSYL)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国半导体行业投资分析报告-行业现状与发展商机研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、阿里巴巴、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型

分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/508946508946.html>